

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZK/01/12/25****Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Tabela 1: Składowe przedmiotu zamówienia

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Oprogramowanie CAD do projektowania obwodów drukowanych PCB | 4 licencje roczne |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

Specyfikacja poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia

| Oprogramowanie CAD do projektowania obwodów drukowanych PCB – 4 licencje roczne | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Oprogramowanie powinno spełniać następujące wymagania: | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Możliwość projektowania płytek PCB (schematy, layouty) oraz PCB wielowarstwowych (minimum 20 warstw) b. Możliwość dodawania układów elektronicznych na schematach i layoutach PCB. c. Możliwość generowania footprintów zgodnie z IPC. d. Możliwość zarządzania bibliotekami komponentów elektronicznych. e. Możliwość integracji z bazą danych komponentów elektronicznych, w tym zewnętrznych programów magazynowych. f. Możliwość integracji z systemem kontroli wersji SVN i Git. g. Wsparcie dla RigidFlex w Solidworks CAD h. Możliwość przesłania modelu obudowy z programów CAD (co najmniej SOLIDWORKS) i. Możliwość hierarchicznej i płaskiej organizacji struktury plików ze schematami elektrycznymi w projekcie. j. Integracja projektu FPGA z projektem układu elektronicznego (schematem ideowym i layoutem PCB). k. Zintegrowany symulator obwodów elektrycznych bazujący na silniku obliczeniowym SPICE. l. Zintegrowane wsparcie dla projektowania systemów elektronicznych składających się z wielu płytek PCB (minimum 3 płytki) – Możliwość stworzenia nadrzędnej struktury połączeń pomiędzy płytkami w całym urządzeniu oraz złożenia wielopłytkowego. Możliwość niezależnego obracania i wyrównywania każdego PCB. m. Możliwość eksportu danych projektowych w celu użycia ich w obliczeniach pól elektromagnetycznych w formatach minimum takich jak: odb++, dxf, step. n. Zintegrowane narzędzie do obliczania impedancji linii transmisyjnych na podstawie pól elektrycznych i magnetycznych w strukturach warstw płytki PCB. o. Zintegrowane narzędzia do automatycznego generowania plików produkcyjnych i montażowych p. Możliwość logowania poprzez autoryzację z zewnętrznych serwisów za pośrednictwem protokołu SAML. q. Możliwość tworzenia grup użytkowników o szczególnych prawach dostępu - minimum 10 użytkowników. r. Możliwość łączenia baz danych - dostęp do danych z zewnętrznych baz danych, m. in. CSV, Excel, Access czy innych baz danych z interfejsem ODBC. s. Obsługa zaawansowanej geometrii – przenoszenie kształtu miedzi, przelotek i metalizowanych padów do MCAD. Zaawansowane sprawdzenia mechaniczne – eksport do plików DXF, STEP, XT/XB (parasolid z zachowaniem ścieżek), import plików STEP, SLDPRTR/SLDASM t. Możliwość pracy grupowej z możliwością zapobiegania konfliktom podczas edytowania dokumentu przez kilka osób. u. Ograniczenie czasowe licencji - 1 rok. | |

Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie licencji w postaci elektronicznej. |
| | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie dokumentacji technicznej w wersji papierowej lub elektronicznej. |



| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przedmiot zamówienia obejmuje również wsparcie techniczne ze strony producenta przez pierwsze 12 miesięcy. |
| | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy. |